

Sch Library:

命名规则:

CHP_XXX	芯片类	
ELE_XXX	普通元件类	例: 电阻电容开关等
HDR_Header_XXX	插头接口类	
	PS: x*x	注明了其接口数
MDE_XXX	模块类	例: MPU6050 NRF24L01
ELE_Standard_XXX	[规范常用]	普通元件类
HANDS_FREE_XXX	[规范常用]	接口类

PROPERTIES:

Default Designator:	例芯片用 U?	[批量 BOM 表 留意]
Description:	具体详细说明	[批量 BOM 表 留意]

Pcb Library:

命名规则:

CHP_XXX	芯片类	
ELE_XXX	普通元件类	例: 电阻电容开关等
HDR_XXX	插头接口类	
MDE_XXX	模块类	

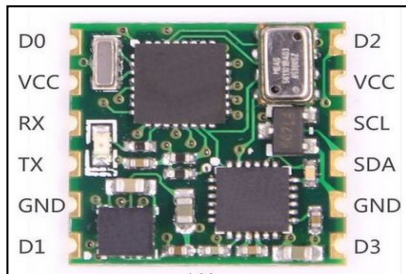
后缀规则:

[大小规格]_[D/P][V/H]_X*X
D: 孔类封装 P: 贴片封装
V: 竖直方向 H: 横向
例: HDR_Header_2.54_DV_1*2
>> 2.54 间距 直插 直排 1*2P 排针/排座

PCB 模块开发规范:

1.板载模块:

图例:



约定:

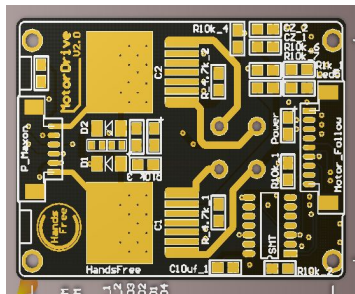
- 1 背面不能有元器件
- 2 除开关 LED 外 尽量选用贴片
- 3 邮票孔

[配套]

- 1: 程序驱动包
- 2: 底板封装 MDE_XXX_BASE
- 3: 描述文件

2.独立模块:

图例:



约定:

- 1 固定铜柱 2mm
- 2 调试用器件 背面
- 3 非调试类器件 正面
- 4 基本信息 LED 显示 贴片

[配套]

- 1: 程序驱动包
- 2: 接头封装 HANDS_FREE_XXX

3. 含 CPU 模块:

图例:

约定:

- 1 兼容原理图原则
- 2 兼容接口接口原则
尽量使用 HANDS_FREE_XXX
- 3 固定铜柱 2mm 等

[PS: 核心板 邮票孔化 待定]

[配套]

- 1: 程序协议包
- 2: 配套接头封装 HANDS_FREE_XXX